

试制设备示例

领域	型号	工艺	工件尺寸/炉内尺寸/传送带宽度 (mm)	温度
半导体	VF-1000HLP	活化退火、高温 H ₂ 退火、真空吹扫可用	高达 φ200mm	800 至 1800°C
	VF-5300H	退火、氧化 (干式、热解)	高达 φ200mm	700 至 1350°C
	VF-5100LP	LP-CVD (多晶硅、Si ₃ N ₄ 、HTO)	高达 φ200mm	600 至 850°C
	VF-3000	退火、氧化 (干式、湿式 (鼓泡))、VCSEL 低温湿式氧化	高达 φ200mm	200 至 1100°C
	VF-1000	退火、氧化 (干式、湿式 (汽化器))、VCSEL 低温湿式氧化、真空吹扫可用	高达 φ300mm	200 至 1100°C
	VF-1000B	VCSEL 低温湿式氧化 (湿式 (汽化器))	高达 φ150mm	200 至 600°C
	VF-5700B	低温退火、PIQ	高达 φ300mm	200 至 750°C
	RLA-1208-V	退火、氧化 (干式)	高达 φ200mm	600 至 1200°C
PV (光伏)	206A-M100	退火、POCl ₃	156 x156mm	400 至 1100°C
FPD	CCBS-IR	用于平板显示器的各种热处理	300(W)×400(L) 至 3000(W)×3200(L)	RT 至 250°C
电子元件	AF-INH21	电子和陶瓷组件、金属组件和其他产品的脱脂、干燥、 无法使用其他常规方法提高加热效率的产品的其他热处理	炉内尺寸: 600(W) × 600(H) × 600(D)	RT+60 至 600°C
	AF-INH100		炉内尺寸: 1000(W) × 1000(H) × 1000(D)	
	AF-μBF		有效尺寸: 200(W) × 200(H) × 400(D)	400 至 900°C
	AF-810A	电子和陶瓷组件、金属组件和其他产品的脱脂、干燥、烧制 无法使用其他常规方法提高加热效率的产品的其他热处理	传送带宽度: 200	250 至 900°C
	多管道抽排气式网带炉	用于电子元件和其他产品的各种热处理	传送带宽度: 350	至 950°C
	小型网带炉	用于电子元件和其他产品的各种热处理	传送带宽度: 200	至 1000°C
	810A-11			
	陶瓷网带式连续炉		可处理工件尺寸: 高达 200(W) × 75(H)	至 1400°C
	高温惰性气体烘箱	电子和陶瓷组件、金属组件和其他产品的脱脂、干燥、各种其他热处理	炉内尺寸: 600(W) × 600(H) × 600(D)	RT+60 至 600°C
	INH-21CD		炉内尺寸: 800(W) × 800(H) × 800(D)	RT+60 至 600°C
	高温惰性气体烘箱			
	INH-51N2-DBS		炉内尺寸: 700(W) × 700(H) × 500(D) *开口尺寸为 630 mm。	RT + 70 至 500°C
	高温洁净烘箱			
	CLH-21CD (V)	半导体晶圆和玻璃基板的烘焙、固化和老化, 电子元件和其他产品的各种热处理		